

平成 25 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社テラプロープ
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627)東証マザーズ
問 合 せ 先 執行役員 CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

**富士通セミコンダクター株式会社の設備の一部譲受け
及び業務受託開始のお知らせ**

当社は、富士通セミコンダクター株式会社が保有する 300mm ウエハのバンパ工程に係る設備を譲受け、当該設備を使用する業務の受託を開始いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設備譲受け及び業務受託開始の理由

富士通セミコンダクター株式会社が保有する 300mm ウエハのバンパ設備の譲渡及び同工程における業務受託は、当社グループが新規顧客の獲得を目指す事業領域の強化に有効であり、企業価値向上に繋がるものと判断いたしました。

2. 譲受けの対象となる設備及び受託する業務

富士通セミコンダクター株式会社が保有する 300mm ウエハのバンパ工程に係る設備及び当該設備を使用するバンパ形成業務。

3. 相手先の概要

(1) 名 称	富士通セミコンダクター株式会社	
(2) 所 在 地	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-23	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡田 晴基	
(4) 事 業 内 容	LSI に関する設計、開発、製造、販売にかかる事業	
(5) 資 本 金	600 億円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 20 年 3 月 21 日	
(7) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社は当該会社から、半導体のテスト業務及びパッケージング業務を受託しております。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

4. 今後の見通し

当該設備の譲受け及び業務受託が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上